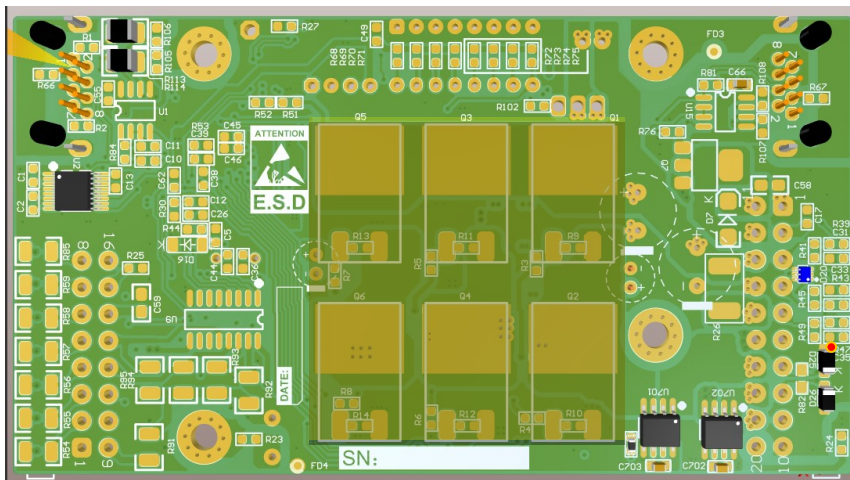


PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	MGRD-4808SM_V4	焊接	QM03323072601	V4	1/1	20230726

1. 功率管焊接要求

功率管 Q1~Q6 共计 6 个 (D2-PAK 封装的管子, 黄色半透明区域) 焊接:

1) 紧贴 PCB 焊接, 不能有浮高, 空焊



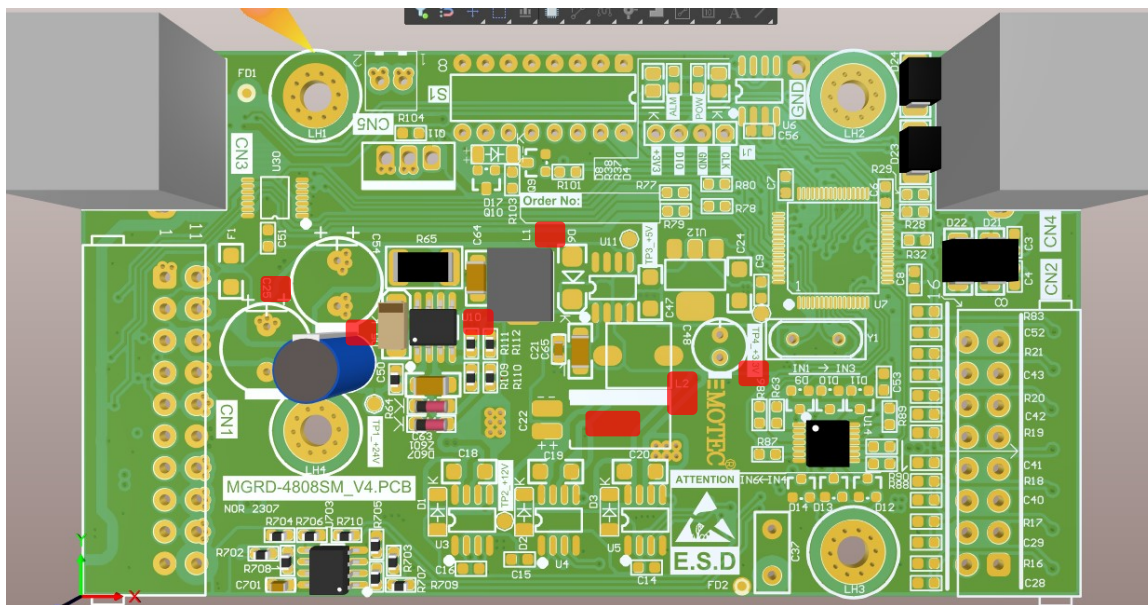
2) 功率管焊接**偏移**接受标准:

- a) 散热面端子 (A) 的侧面偏移不大于端子宽度的 3% (约 0.3mm, 右图为焊接不良图片)
- b) 散热面末端端子连接宽度在与焊盘接触区域有 100% 润湿



2. 固定胶位置图

红色半透明色块区域为点胶位置分布图, 点固定胶 (黑色 704 固定胶), 点胶厚度为 1.5mm;



3. 其他常规焊接要求:

- 1) 所有端口插座焊接需要压到底焊接, 不接受歪扭, 偏差要小于 0.3mm;
- 2) 所有极性元件, 严禁方向反;
- 3) 不接受虚焊, 空焊, 焊锡短路;
- 4) 未特殊说明的元件, 均紧贴线路板焊接;
- 5) 手工操作要做防静电处理;
- 6) 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准;
- 7) 贴装元件位置图详见焊接丝印图文件
- 8) 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准;

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	